

SL-SMT 5.08HC/03/270GL 3.2AU BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = сильноточный.

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто. Соединение THT/THR под пайку, 5.08 мм, Количество полюсов: 3, 270°, Длина контактного штифта (l): 3.2 мм, позолоченный, черный, Ящик
Номер для заказа	1446350000
Тип	SL-SMT 5.08HC/03/270GL 3.2AU BK BX
GTIN (EAN)	4050118251524
Кол.	100 Шт.
Продуктное отношение	IEC: / 27.5 A UL: / 18.5 A
Дата создания	8 апреля 2021 г. 8:57:25 CEST
Упаковка	Ящик

SL-SMT 5.08HC/03/270GL 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	11,7 мм	Высота (в дюймах)	0,461 inch
Высота, мин.	8,5 мм	Глубина	12 мм
Глубина (дюймов)	0,472 inch	Масса нетто	1,713 g
Ширина	18,44 мм	Ширина (в дюймах)	0,726 inch

Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	60 мм
VPE с	102 мм	Высота VPE	115 мм

Системные характеристики

Серия изделия	OMNIMATE Signal – серия BL/SL 5.08	Вид соединения	Соединение с платой
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	Шаг в мм (P)	5,08 мм
Шаг в дюймах (P)	0,2 inch	Угол вывода	270°
Количество полюсов	3	Длина контактного штифта (l)	3,2 мм
Допуск на длину выводов под пайку	0 / -0,3 мм	Размеры выводов под пайку	d = 1,2 мм, восьмиугольный
L1 в мм	10,16 мм	L1 в дюймах	0,4 inch
Количество рядов	1	Количество полюсных рядов	1
Объемное сопротивление	≤5 мΩ	Усилие вставки на полюс, макс.	9 N
Усилие вытягивания на полюс, макс.	7 N		

Данные о материалах

Цветовой код	черный	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011
Группа изоляционного материала	IIIa	Сравнительный показатель пробоя (СТИ)	≥ 175
Материал контакта	CuMg	Поверхность контакта	позолоченный
Структура слоев соединения под пайку	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn матовый	Структура слоев штепсельного контакта	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn / 1,7...2,3 μm Au
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-30 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	27,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	19 A	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	24 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	16,5 A		

Номинальные характеристики по CSA

Номинальный ток (группа использования B/CSA)	18,5 A	Номинальный ток (группа использования D/CSA)	18,5 A
--	--------	--	--------

SL-SMT 5.08HC/03/270GL 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR)



Сертификат № (UR)

E60693

Номинальный ток (группа использования В/UL 1059)

Ссылка на утвержденные значения

В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

18,5 А

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

Важное примечание

Соответствие IPC

Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.

Примечания

- Позолоченные контактные поверхности по запросу
- Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
- Диаметр монтажной петельки D = 1,4+0,1 мм
- Диаметр монтажного отверстия под пайку D = 1,5 + 0,1 мм, для 9 контактов
- Р на чертеже – шаг
- Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
- Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °С и средней влажности 70%, 36 месяцев

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E60693

Загрузки

Технические данные

[STEP](#)

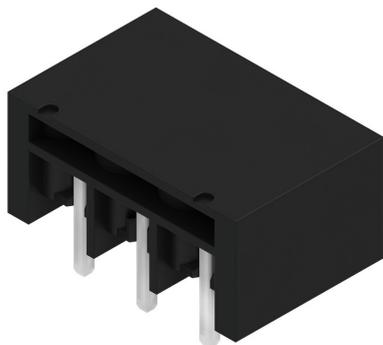
SL-SMT 5.08HC/03/270GL 3.2AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

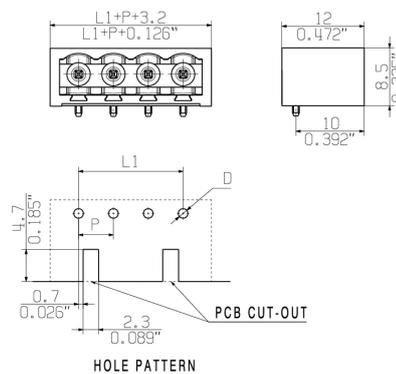
www.weidmueller.com

Изображения

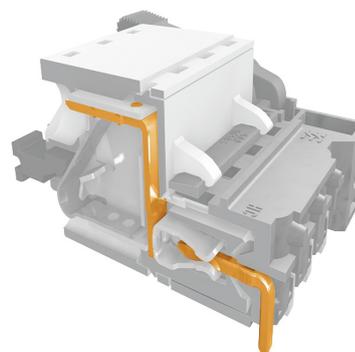
Изображение изделия



Dimensional drawing



Преимущество изделия



Safe power transmission
 Proven properties

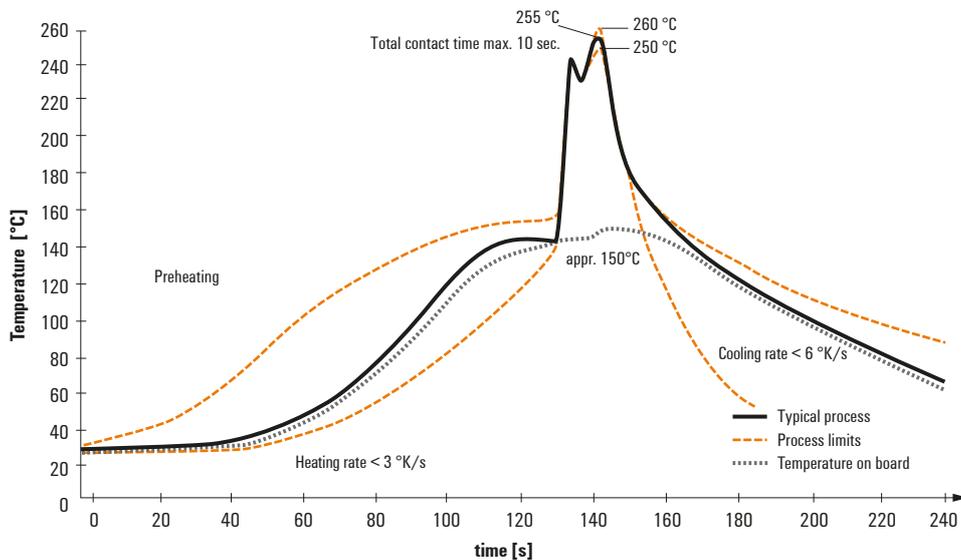
Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

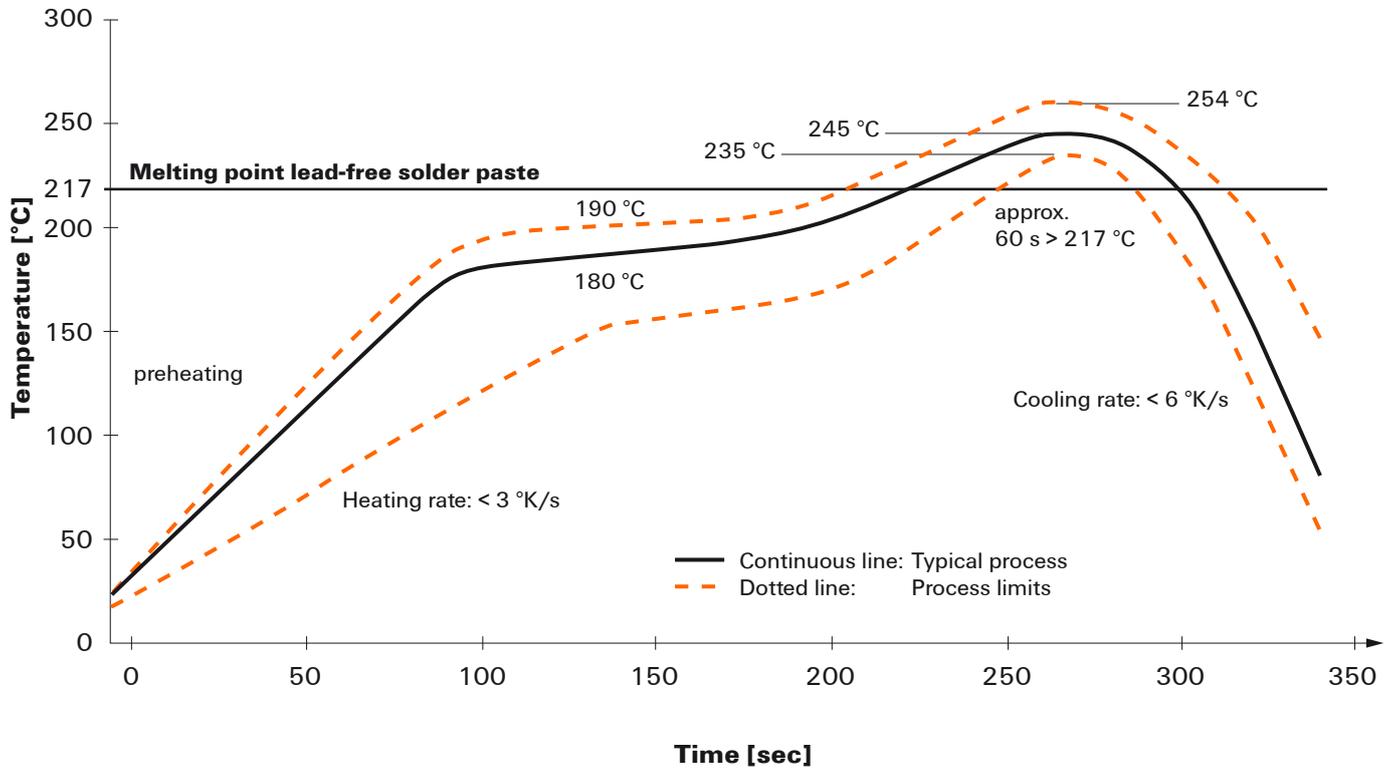
When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.